

**中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会**  
**关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划**  
**和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明**

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下：

1、本次交易的标的资产为交易对方所持有的标的公司股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在本次交易的预案中详细披露本次交易涉及的有关审批事项，并对本次交易可能无法获得批准的风险作出了特别提示；

2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；也不存在交易对方出资不实或者影响其合法存续的情况；

3、本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与关联人保持独立。本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；

4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性、不会导致新增重大不利影响的同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

特此说明。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日